

2018年中国芯片设计行业分析报告- 市场运营态势与发展前景研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国芯片设计行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/363002363002.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

我国芯片设计业的产品范围已经涵盖了几乎所有门类，且部分产品已拥有了一定的市场规模，但我国芯片产品总体上仍然处于中低端，在高端市场上还无法与国外产品展开竞争。

芯片设计位于半导体产业的最上游，是半导体产业最核心的基础，拥有极高的技术壁垒，需要大量的人力、物力投入，需要较长时间的技术积累和经验沉淀。目前，国内企业在CPU等关键领域与国外企业仍有较大的技术差距，短时间内实现赶超具有很大难度。但从近几年的产业发展来看，技术差距正在逐步缩小。同时，在国家大力倡导发展半导体的背景下，逐步实现芯片国产化可期。

当前，我国在完善基础设施、丰富人力资本、完备产业体系、广阔市场空间、高效动员体制等方面形成了突出优势。我国产业技术水平越来越接近全球前沿，高铁、特高压输变电、通信设备、网络应用等部分领域跻身世界先进行列。

近年来，我国芯片设计业规模和质量稳步提升，细分领域实现较大突破，国产芯片对关键领域的支撑能力显著增强，先进工艺生产线建设速度不断加快，封装测试业接近国际先进水平。其中，海思半导体、紫光展锐等开发的移动处理芯片，全球市场占有率超过20%；海思半导体与创维电视紧密合作，实现了智能电视核心芯片零突破，市场占有率接近30%；全部采用国产CPU的“神威·太湖之光”超级计算机连续4次位列全球超算500强首位；杭州中天微电子嵌入式CPU累计出货量约6亿颗；截至2017年，基于SM系列国家密码算法的标准金融IC卡芯片累计出货已突破3.7亿颗。我国还形成了比较完整的北斗导航芯片技术体系，2017年应用北斗技术的终端超过3000万台。

我国芯片设计行业技术优势：

一是具有规模雄厚的产业优势。我国已形成世界上最完整的制造业体系，连续8年位列全球制造业第一大国，在世界500种主要工业品中，中国有220种产品产量位居全球第一位。

二是我国是世界上最大的制造业需求潜力国，市场需求已连续多年居世界第二位，近两年将成为最大的需求市场。我国中等收入人群已达4亿人，多层次需求趋势进一步显现。

三是得益于集中力量办大事的制度优势，我们在高铁、通信设备、核电等领域取得了举世瞩目的业绩。

四是我国具有无可比拟的人才资源优势。我国科技人力资源超过8000万人，工程师数量占全世界的1/4，每年培养的工程师相当于美国、欧洲、日本和印度的总和。近年来海外留学归国人才倍增，国际高端人才加速向我国汇聚。

观研天下发布的《2018年中国芯片设计行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章芯片设计行业发展概述

第一节芯片设计行业概述

- 一、芯片设计的定义
- 二、芯片设计的特性

第二节行业界定

- 一、行业经济特性
- 二、细分市场概述

第三节芯片设计行业发展成熟度分析

- 一、芯片设计行业发展周期分析
- 二、中外芯片设计市场成熟度对比
- 三、细分行业成熟度分析

第二章国外芯片设计行业发展分析

第一节全球芯片设计行业发展现状

- 一、2016-2018年全球芯片设计行业产业规模
- 二、2016-2018年全球芯片设计行业产业结构

第二节全球芯片设计行业基本特点

- 一、市场繁荣带动产业加速发展
- 二、企业重组呈现强强联合趋势

第三节主要国家和地区发展分析

- 一、2016-2018年美国芯片设计行业发展分析
- 二、2016-2018年日本芯片设计行业发展分析
- 三、2016-2018年台湾芯片设计行业发展分析
- 四、2016-2018年印度芯片设计行业发展分析

第四节世界芯片设计行业发展现状分析

- 一、2016-2018年世界芯片设计行业发展规模分析
- 二、2016-2018年世界芯片设计行业发展特点分析
- 三、2016-2018年世界芯片设计行业竞争格局分析

第五节 2018年世界芯片设计行业发展形势分析

第六节2018-2024年世界芯片技术发展趋势分析

- 一、小型化、高灵敏度
- 二、多功能趋势
- 三、芯片节能趋势

第三章我国芯片设计行业发展现状

第一节中国芯片设计行业现状

- 一、行业规模不断扩大
- 二、行业质量稳步提高
- 三、产品结构极大丰富
- 四、原材料与生产设备配套问题

第二节芯片设计行业发展特点

- 一、产业持续快速发展

二、中国自主标准为国内设计企业带来发展机遇

三、模拟IC和电源管理芯片成为国内IC设计热门产品

第三节 2016-2018年芯片设计行业发展分析

一、2016-2018年芯片设计行业经济指标分析

二、2016-2018年芯片设计业进出口贸易分析

三、2016-2018年行业盈利能力与成长性分析

四、2016-2018年芯片设计行业发展规模分析

五、2016-2018年芯片设计行业发展特点分析

第四节中国芯片设计业存在的主要问题分析

一、企业规模问题分析

二、产业链问题分析

三、资金问题分析

四、人才问题分析

五、发展的建议与措施

第四章中国芯片设计市场运行分析

第一节 2018年中国芯片设计市场发展分析

一、2018年中国芯片设计市场消费规模分析

二、2018年主要行业对芯片的需求统计分析

三、2018年中国芯片设计市场消费规模分析

四、2018年主要行业对芯片的需求分析预测

第二节 2018年中国芯片制造市场生产状况分析

一、2018年芯片的产量分析

二、2018年芯片的产能分析

三、2018年产品生产结构分析

四、2018年芯片的产量分析

五、2018年芯片的产能分析

第五章芯片设计产品细分市场分析

第一节 2018年中国芯片细分市场发展局势分析

一、生物芯片

二、通信芯片

三、显示芯片

四、数字电视芯片

五、标签芯片

第二节电子芯片市场

- 一、电子芯片市场结构
- 二、电子芯片市场特点
- 三、2018年电子芯片市场规模
- 四、2018年电子芯片市场分析
- 五、2018-2024年电子芯片市场预测

第三节通讯芯片市场

- 一、通讯芯片市场结构
- 二、通讯芯片市场特点
- 三、2018年通讯芯片市场规模
- 四、2018年通讯芯片市场分析
- 五、2018-2024年通讯芯片市场预测

第四节汽车芯片市场

- 一、汽车芯片市场结构
- 二、汽车芯片市场特点
- 三、2018年汽车芯片市场规模
- 四、2018年汽车芯片市场分析
- 五、2018-2024年汽车芯片市场预测

第五节手机芯片市场

- 一、手机芯片市场结构
- 二、手机芯片市场特点
- 三、2018年手机芯片市场规模
- 四、2018年手机芯片市场分析
- 五、2018-2024年手机芯片市场预测

第六节电视芯片市场

- 一、电视芯片市场结构
- 二、电视芯片市场特点
- 三、2018年电视芯片市场规模
- 四、2018年电视芯片市场分析
- 五、2018-2024年电视芯片市场预测

第六章芯片设计产业发展地区比较

第一节长三角地区

- 一、竞争优势
- 二、2016-2018年发展状况

三、2018-2024年发展前景

第二节 珠三角地区

一、竞争优势

二、2016-2018年发展状况

三、2018-2024年发展前景

第三节 环渤海地区

一、竞争优势

二、2016-2018年发展状况

三、2018-2024年发展前景

第四节 东北地区

一、竞争优势

二、2016-2018年发展状况

三、2018-2024年发展前景

第五节 西部地区

一、竞争优势

二、2016-2018年发展状况

三、2018-2024年发展前景

第七章 芯片设计行业竞争格局分析

第一节 中国芯片设计行业结构分析

一、行业的省份分布概况

二、行业销售集中度分析

三、行业利润集中度分析

四、行业规模集中度分析

第二节 芯片设计业竞争格局分析

一、国际芯片设计行业的竞争状况

二、我国芯片设计业的国际竞争力

三、外资企业进入国内市场的影响

四、IC设计企业面临的挑战分析

第三节 我国芯片设计业的竞争现状

一、我国芯片设计企业间竞争状况

二、潜在进入者的竞争威胁

三、供应商与客户议价能力

第四节 2016-2018年芯片设计行业竞争格局分析

一、2018年国内外芯片设计竞争分析

- 二、2018年我国芯片设计市场竞争分析
- 三、2018年我国芯片设计市场集中度分析
- 四、2018年国内主要芯片设计企业动向

第八章芯片设计企业竞争策略分析

第一节芯片设计市场竞争策略分析

- 一、2018年芯片设计市场增长潜力分析
- 二、2018年芯片设计主要潜力品种分析
- 三、现有芯片设计产品竞争策略分析
- 四、潜力芯片设计品种竞争策略选择
- 五、典型企业产品竞争策略分析

第二节芯片设计企业竞争策略分析

- 一、金融危机对芯片设计行业竞争格局的影响
- 二、金融危机后芯片设计行业竞争格局的变化
- 三、2018-2024年我国芯片设计市场竞争趋势
- 四、2018-2024年芯片设计行业竞争格局展望
- 五、2018-2024年芯片设计行业竞争策略分析
- 六、2018-2024年芯片设计企业竞争策略分析

第九章世界典型芯片设计企业竞争分析

第一节高通（QUALCOMM）

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业经营状况分析
 - 1、企业偿债能力分析
 - 2、企业运营能力分析
 - 3、企业盈利能力分析
- 四、企业竞争优势分析

第二节博通（BROADCOM）

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业经营状况分析
 - 1、企业偿债能力分析
 - 2、企业运营能力分析
 - 3、企业盈利能力分析

四、企业竞争优势分析

第三节 NVIDIA

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业经营状况分析

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

四、企业竞争优势分析

第四节新帝 (SANDISK)

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业经营状况分析

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

四、企业竞争优势分析

第五节 AMD

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业经营状况分析

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

四、企业竞争优势分析

第十章芯片设计优势企业竞争分析

第一节上海华虹

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业经营状况分析

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

四、企业竞争优势分析

第二节中星微电子

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业经营状况分析
 - 1、企业偿债能力分析
 - 2、企业运营能力分析
 - 3、企业盈利能力分析
- 四、企业竞争优势分析

第三节中芯国际

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业经营状况分析
 - 1、企业偿债能力分析
 - 2、企业运营能力分析
 - 3、企业盈利能力分析
- 四、企业竞争优势分析

第四节大唐微电子

- 一、企业发展简况分析
- 二、企业产品服务分析
- 三、企业经营状况分析
 - 1、企业偿债能力分析
 - 2、企业运营能力分析
 - 3、企业盈利能力分析
- 四、企业竞争优势分析

第十一章芯片设计行业发展趋势分析

第一节 2018年发展环境展望

- 一、2018年宏观经济形势展望
- 二、2018年政策走势及其影响
- 三、2018年国际行业走势展望

第二节 2018年相关行业发展展望

- 一、2018年IC制造业展望
- 二、2018年IC封装测试业展望
- 三、2018年IC材料和设备行业展望

第三节芯片设计行业发展趋势分析

一、技术发展趋势分析

二、产品发展趋势分析

三、行业竞争格局展望

第四节2018-2024年中国芯片设计市场趋势分析

一、2016-2018年芯片设计市场趋势总结

二、2018-2024年芯片设计发展趋势分析

三、2018-2024年芯片设计市场发展空间

四、2018-2024年芯片设计产业政策趋向

五、2018-2024年芯片设计技术革新趋势

六、2018-2024年芯片设计价格走势分析

七、2018-2024年国际环境对行业的影响

第十二章未来芯片设计行业发展预测

第一节2018-2024年国际芯片设计市场预测

一、2018-2024年全球芯片设计行业产值预测

二、2018-2024年全球芯片设计市场需求前景

三、2018-2024年全球芯片设计市场价格预测

第二节2018-2024年国内芯片设计市场预测

一、2018-2024年国内芯片设计行业产值预测

二、2018-2024年国内芯片设计市场需求前景

三、2018-2024年国内芯片设计市场价格预测

四、2018-2024年国内芯片设计行业集中度预测

第十三章芯片设计行业投资现状分析

第一节 2018年芯片设计行业投资情况分析

一、2018年总体投资及结构

二、2018年投资规模情况

三、2018年投资增速情况

四、2018年分行业投资分析

五、2018年分地区投资分析

六、2018年外商投资情况

第二节 2018年芯片设计行业投资情况分析

一、2018年总体投资及结构

二、2018年投资规模情况

三、2018年投资增速情况

四、2018年分行业投资分析

五、2018年分地区投资分析

六、2018年外商投资情况

第十四章芯片设计行业投资环境分析

第一节经济发展环境分析

一、2016-2018年我国宏观经济运行情况

二、2018-2024年我国宏观经济形势分析

三、2018-2024年投资趋势及其影响预测

第二节政策法规环境分析

一、2018年芯片设计行业政策环境

二、2018年国内宏观政策对其影响

三、2018年行业产业政策对其影响

第三节社会发展环境分析

一、国内社会环境发展现状

二、2018年社会环境发展分析

三、2018-2024年社会环境对行业的影响分析

第四节电子信息产业振兴规划

一、电子信息产业振兴规划概述

二、电子信息产业振兴规划细则

三、电子信息产业振兴规划三大任务

四、电子信息产业振兴规划六大工程

五、电子信息产业振兴规划十项措施

六、电子信息产业振兴规划的意义与作用

七、电子信息产业振兴规划对芯片设计行业的影响

第十五章芯片设计行业投资机会与风险

第一节2018-2024年行业投资机会分析

一、台湾放行四家芯片商投资大陆

二、半导体芯片产业或成投资热点

三、应用芯片研究前景广阔

四、生物芯片投资时刻到来

第二节芯片设计行业投资效益分析

一、2016-2018年芯片设计行业投资状况分析

二、2018-2024年芯片设计行业投资效益分析

三、2018-2024年芯片设计行业投资趋势预测

四、2018-2024年芯片设计行业的投资方向

五、2018-2024年芯片设计行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第三节影响芯片设计行业发展的主要因素

一、2018-2024年影响芯片设计行业运行的有利因素分析

二、2018-2024年影响芯片设计行业运行的稳定因素分析

三、2018-2024年影响芯片设计行业运行的不利因素分析

四、2018-2024年我国芯片设计行业发展面临的挑战分析

五、2018-2024年我国芯片设计行业发展面临的机遇分析

第四节芯片设计行业投资风险及控制策略分析

一、2018-2024年芯片设计行业市场风险及控制策略

二、2018-2024年芯片设计行业政策风险及控制策略

三、2018-2024年芯片设计行业经营风险及控制策略

四、2018-2024年芯片设计行业技术风险及控制策略

五、2018-2024年芯片设计同业竞争风险及控制策略

六、2018-2024年芯片设计行业其他风险及控制策略

第十六章芯片设计行业投资战略研究

第一节芯片设计行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节对我国芯片设计品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、芯片设计实施品牌战略的意义

三、芯片设计企业品牌的现状分析

四、我国芯片设计企业的品牌战略

五、芯片设计品牌战略管理的策略

第三节芯片设计产业发展策略

一、芯片设计后续项目谈判策略

- 二、芯片设计企业发展策略分析
- 三、我国芯片设计产业提高全球交付能力策略
- 四、中国芯片设计业发展策略
- 第四节芯片设计行业投资战略研究
 - 一、2018年电子产业行业投资战略
 - 二、2018年芯片设计行业投资战略
 - 三、2018-2024年芯片设计行业投资战略
 - 四、2018-2024年细分行业投资战略

图表目录：

- 图表：芯片设计产业的价值链
- 图表：芯片设计产业与其他产业的关系
- 图表：芯片设计产业链结构图
- 图表：2016-2018年中国集成电路产业销售收入规模及增长
- 图表：2018年中国集成电路产业各产业链销售收入及增长
- 图表：2018年中国集成电路产业各价值链结构
- 图表：全球IC设计产业产值发展趋势
- 图表：2018年全球半导体电子设备设计国家排名
- 图表：全球IC设计产业布局
- 图表：全球IC设计产业概况
- 图表：2018年台湾地区前十大设计公司
- 图表：台湾地区历年前十大设计公司营收变化趋势
- 图表：2016-2018年间国内生产总值增长趋势
- 图表：2016-2018年各季度国内生产总值走势
- 图表：2016-2018年工业增加值及增长速度
- 图表：2018年主要工业产品产量及其增长速度
- 图表：2018年规模以上工业企业实现利润及其增长速度
- 图表：2016-2018年固定资产投资增长情况
- 图表：我国有线电视向数字化过渡时间表
- 图表：低功率芯片技术实现（GYZQPT）

图表详见正文

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/363002363002.html>